

Job Description

사업부	직무	모집전공	근무지
Test & System Package 총괄	패키지개발	전기전자(HW), 재료/금속, 화학/화공, 기계 물리, 이공기타	화성, 천안, 온양
	패키지기술	전기전자(HW), 재료/금속, 기계, 이공기타	천안, 온양
	설비기술	전기전자(HW), 재료/금속, 기계, 이공기타	천안, 온양

TSP 총괄 (Test & System Package)

패키지개발

충청남도 아산, 천안 / 경기도 화성

최적화된 구조의 반도체 Package 와 이를 구현하기 위한 Package 공정개발을 연구하여 첨단 반도체 제품을 개발하는 직무

Role

■ Package Process Integration

- 메모리, S.LSI 및 Foundry 사업부 向 Package 제품개발
- Package 신규 구조 발굴 및 구현 방안 제시(TSV, FOPKG 등 선행제품/공정 개발)
- 개발 일정, Risk 관리 및 제품 연관 요소기술 Integration

■ Package Process Development

- Package 단위공정 및 요소기술 개발
- Package 에 적용하는 Organic, Inorganic Material 개발

■ Package Design

- Device 와 Set Board 간 신호, 전력 전송을 위한 Package Design
- Package Electrical/Thermal/Mechanical 최적화 Simulation
- Package 공정/신뢰성 Risk 에 대한 예측 알고리즘 개발

■ RFA (Reliability & Failure Analysis)

- Package 의 신뢰성 확보를 위한 소재와 구조에 대한 연구
- 신뢰성 평가기술, 가속수명시험 개발 및 기준 제정
- 분석기술 개발, 불량 분석 및 불량 Mechanism 규명

Job Description

TSP 총괄 (Test & System Package)

패키지기술

충청남도 아산, 천안

반도체 공정품질 확보, 불량 원인 적기 발굴/해결, 생산성 극대화, 원가 경쟁력 향상을 통해 Package의 가치를 극대화하는 직무

Role

■ 공정 기술

- Package 단위 공정 생산성 향상, 품질 문제 분석 및 해결
- 신 공정기술 발굴, 적용 및 공정 표준화, 원가 절감 및 Process 효율화

■ 가상검증, Defect 제어 기술

- 구조, 열응력, 유체, 파티클, 발열/방열에 대한 Simulation
- 설비, 환경, 제품, 원부자재의 청정도 개선 및 ESD/EOS 기술 연구

■ 분석/소재 기술

- 불량 원인 규명을 위한 분석 Data 제공 및 솔루션 제시
- 반도체 Package 용 신규 소재 개발 및 양산 소재 최적화

■ 양산품질 보증/Yield 개선

- 공정 변경점 및 산포 관리를 통해 품질 위험요소를 관리/개선 하여 공정 품질 향상
- Yield 개선(Data Analytics, Machine Learning, Analytics)
: 품질 Data 분류, Grouping 을 통한 유효인자 감지

Job Description

TSP 총괄 (Test & System Package)

설비기술

충청남도 아산, 천안

최고 품질의 반도체 제품 생산을 위한 설비를 유지 관리하고 혁신적인 설비 가치 창출과 함께 미래 반도체 제조환경을 구현하는 직무

Role

■ 첨단 반도체 설비 유지 / 보수

- 지속 생산 가능한 반도체 설비 관리
 - 반도체 설비 유지 보수 (고장조치, Part 교체, 불합리 개선)
 - 반도체 설비 Data Trend 분석 및 개선 활동
 - 예측 가능한 설비관리 Tool 개발

■ 설비 개조 / 개선

- 반도체 설비, 시스템의 구조를 이해하고 설비 고유의 성능을 개선하여 생산성 향상
 - 설비 생산성 향상을 위한 반도체 설비 개조 및 시스템 개발
- 제품과 설비 동작 및 작업 환경을 이해하고 최고의 제품 생산을 위한 Solution 개발
 - 반도체 생산을 위한 설비 기구 및 작업 환경 구축

■ 제조 인프라 개선

- 제품 가치 및 로봇기반 스마트 제조환경 향상을 위한 물류 자동화, 운영 시스템 설계
- Big Data 활용한 실시간 제조현장 모니터링 설계, 제조 플랫폼 기술 개발

Pluses

- 기구 설계(Auto CAD, Inventor, CATIA) 및 시스템 Tool (C 언어/Java 等) 역량 보유자
 - 반도체 Package 및 품질 직무와 연관된 대내외 활동 경험 보유자
 - 반도체 Package 공정 및 품질 관련 졸업논문 및 국내/외 저널 논문 보유자
 - 반도체 Package 관련 Simulation Tool (ABAQUS, ANSYS, LS-Dyna 등) 역량 보유자
 - 기계적/열특성 분석, 성분 분석 등 다양한 분야의 분석 역량 보유자
 - 품질직무에 대한 기본적인 지식 보유자
- # 품질 공학, 환경안전, PL(Product Liability), SPC, 생산관리, Test Engineering, Big Data 해석